

ガラスハーメチック(気密端子・コネクタ)への 高精度な金めっき量産技術

～価格競争力に自信あり～

特徴

1. 低コストの量産処理が可能です

電解めっきのベースとリードピンの膜厚差が小さい(膜厚比 約1:1.5)
量産バッチでも固体ごとの膜厚ばらつき幅を小さくできます。
形状・ピン径に合わせ、通電用ダミーを最小数で済むようカスタムします。

2. ワイヤーボンディングのための専用金めっき被膜

長年の実績から、専用のめっき液組成で対応

3. 変形・絡まりやすい、多ピンでリードが長いピンもOK

様々なめっき治具を用意しており、製品へのストレスが少ないめっきができます。

4. 扱いが難しい小型品(ステム径Φ2・ピン径Φ0.25)も対応可能

5. セラミックベースのピンのみめっきOK

めっき仕様

• ニッケルめっき(下地or仕上げ)

電解ニッケルめっき(Ni) : 光沢・無光沢

無電解ニッケルめっき(Ni-P)

• 金めっき仕上げ : 軟質めっき (ワイヤーボンディング専用めっき)

電解金めっき(Au) : 無光沢

無電解金めっき(Au) : 無光沢

用途

- ステム(光素子用、各種センサ・トランジスタ・IC 等)
- コネクタ(高電圧・高電流・耐水・耐圧用 等)



～ 不可能への挑戦 ～

株式会社 友電舎

大阪市此花区常吉2-4-8

TEL : 06-6465-1663

e-mail : info@ydn.co.jp

URL : <http://www.ydn.co.jp>